

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成18年1月12日(2006.1.12)

【公開番号】特開2000-164644(P2000-164644A)

【公開日】平成12年6月16日(2000.6.16)

【出願番号】特願平10-333793

【国際特許分類】

H 01 L 21/60 (2006.01)

H 01 L 21/52 (2006.01)

【F I】

H 01 L 21/60 3 1 1 W

H 01 L 21/52 E

【手続補正書】

【提出日】平成17年11月18日(2005.11.18)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】少なくとも1層以上の保護フィルム層と、エポキシ樹脂(A)および熱可塑性樹脂(B)を含有する熱硬化型の接着剤層からなる積層体を有する半導体装置用接着剤シートであって、前記接着剤層と接着剤層の10倍重量の純水を121 / 100%RHの条件で20時間抽出処理したときの抽出水pHが4~9の範囲であることを特徴とする半導体装置用接着剤シート。

【請求項2】接着剤層がハイドロタルサイト系化合物(C)を含有する熱硬化型の接着剤層であることを特徴とする請求項1記載の半導体装置用接着剤シート。

【請求項3】熱可塑性樹脂(B)がブタジエンを必須共重合成分とする熱可塑性樹脂(B')を含有することを特徴とする請求項1記載の半導体装置用接着剤シート。

【請求項4】熱可塑性樹脂(B)がブタジエンを必須共重合成分とし、かつカルボキシル基を有する熱可塑性樹脂(B")を含有することを特徴とする請求項1記載の半導体装置用接着剤シート。

【請求項5】無機質充填材(D)を含有することを特徴とする請求項1記載の半導体装置用接着剤シート。

【請求項6】保護フィルム層、接着剤層、金属板の順に積層された半導体装置用部品において、前記接着剤層がエポキシ樹脂(A)および熱可塑性樹脂(B)を含有する熱硬化型の接着剤層であって、該接着剤層と接着剤層の10倍重量の純水を121 / 100%RHの条件で20時間抽出処理したときの抽出水pHが4~9の範囲であることを特徴とする半導体装置用部品。

【請求項7】保護フィルム、接着剤層、絶縁体層および導体パターンからなる配線基板の順に積層された半導体装置用部品において、前記接着剤層がエポキシ樹脂(A)および熱可塑性樹脂(B)を含有する熱硬化型の接着剤層であって、該接着剤層と接着剤層の10倍重量の純水を121 / 100%RHの条件で20時間抽出処理したときの抽出水pHが4~9の範囲であることを特徴とする半導体装置用部品。

【請求項8】少なくとも1層以上の接着剤層を有する半導体装置において、前記接着剤層がエポキシ樹脂(A)および熱可塑性樹脂(B)を含有する熱硬化型の接着剤層であって、該接着剤層と接着剤層の10倍重量の純水を121 / 100%RHの条件で20時間抽出処理したときの抽出水pHが4~9の範囲であることを特徴とする半導体装置。

**【手続補正2】****【補正対象書類名】**明細書**【補正対象項目名】**0016**【補正方法】**変更**【補正の内容】****【0016】****【課題を解決するための手段】**

すなわち、本発明は少なくとも1層以上の保護フィルム層と、エポキシ樹脂（A）および熱可塑性樹脂（B）を含有する熱硬化型の接着剤層からなる積層体を有する半導体装置用接着剤シートであって、前記接着剤層と接着剤層の10倍重量の純水を121 / 100 % R Hの条件で20時間抽出処理したときの抽出水pHが4~9の範囲であることを特徴とする半導体装置用接着剤シートおよびそれを用いた部品ならびに半導体装置である。